

運用指針

第2条 - 口 現場特有の状況に対応するための創意工夫

暫定施工を考慮した端末部の舗装構成の見直し

端末IC暫定ランプの下層路盤の工法・材料の見直し

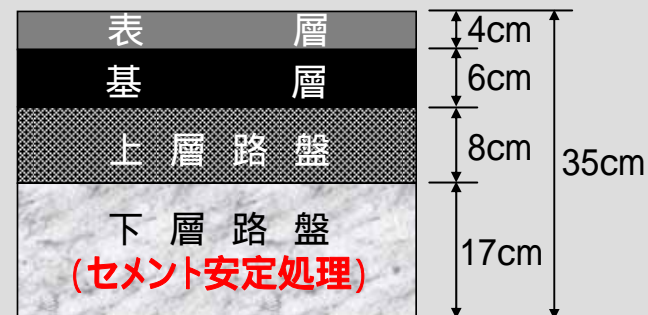
【当初計画】 中部横断自動車道 増穂IC

$T_A = 17$ 舗装厚: 35cm T_A (等値換算舗装厚): 舗装設計において、路床強度や大型車交通量から求められる確保すべき基準値

設計要領 第一集「舗装編」(抜粋)

アスファルト舗装の下層路盤は、原則として、セメント安定処理工法を用いる。

(舗装構成)



下層路盤はセメント安定処理工法にて計画

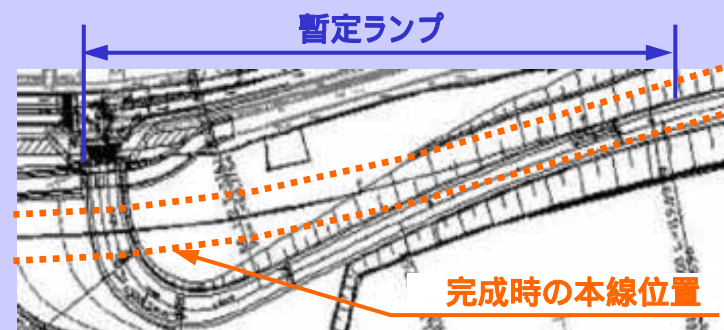
$$T_A = (4 + 6) \times 1.00 + 8 \times 0.80 + 17 \times 0.28 = 21.16 > 17$$

(増穂IC)

中部横断自動車道(六郷IC~増穂IC)の供用(平成28年度予定)までの10年間は端末ICとなる。

10年間は暫定ランプ形状で運用

舗装構成を見直し

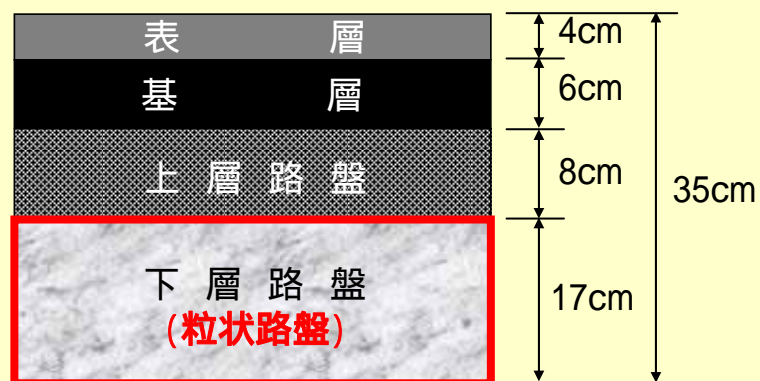


下層路盤をセメント安定処理路盤から粒状路盤に見直すことを検討

端末IC暫定ランプの下層路盤の工法・材料の見直し

$T_A = 17$ 舗装厚: 35cm(最小厚)を確保しつつ舗装構成を見直し

[舗装構成の見直し]



$$T_A = (4 + 6) \times 1.00 + 8 \times 0.80 + 17 \times 0.25 = 20.65 > 17$$

必要な耐久性は確保できることを確認



増穂IC暫定ランプ

検討の結果、下層路盤を粒状路盤に変更

適正な品質の確保について

下層路盤に用いる粒状材料及び下層路盤の施工管理

【材料試験及び規定値】

試験項目	試験方法	規定値	摘要	判定
ふるい分け試験	JIS A 1102	設計標準粒度範囲		
塑性指数	JIS A 1205	6以下		
すりへり試験	JIS A 1121	50%以下		
CBR試験	JIS A 1211	30%以上	95%修正CBR	

【本施工における日常管理試験項目及び規定値】

試験項目	試験方法	規定値	摘要	判定
ふるい分け試験	JIS A 1102	設計標準粒度範囲		
塑性指数	JIS A 1205	6以下		
締固め度	JHS 105	95%以上		
プルーフローリング たわみ測定	JHS 101 JHS 102	3mm以下		



下層路盤(粒状路盤)に求められる適正な品質を確保



端末IC暫定ランプの下層路盤を粒状路盤に変更することによる材料費及び施工費の縮減

(上記のコスト縮減以外のメリット)

- ・ 暫定ランプ撤去時に、セメント安定処理路盤の場合に必要な取壊し(破碎)を行う必要がない。
- ・ 暫定ランプ撤去時に、粒状路盤材のリサイクルが可能 → 循環型社会の形成に貢献

経営努力要件適合性の認定について

端末IC暫定ランプの下層路盤を粒状路盤に変更することは、**適正な品質を確保しつつ、現場特有の状況に対応するための創意工夫**である。

運用指針第2条第1項第1号口に該当

端末IC暫定ランプの下層路盤を粒状路盤に変更することによる材料費及び施工費の縮減



会社の経営努力によるものであると認定

助成金交付における経営努力要件適合性の認定に関する運用指針（抜粋）

第二条 経営努力要件適合性の認定基準

機構は、助成金交付申請をした高速道路会社の主体的かつ積極的な努力による次の各号に掲げる費用の縮減（適正な品質や管理水準を確保したものに限る。）について、経営努力要件適合性の認定を行うものとする。

次に掲げるいずれかにより、道路の計画、設計又は施工方法を変更したことによる費用の縮減。

ロ、申請の対象である現場特有の状況に対応するための創意工夫